www.datapaq.com

써멀 배리어

전자 어셈블리 산업용

Datapaq 써멀 배리어는 업계 최고의 크기/성능 조합을 제공하는 것으로 인정 받는 제품입니다. 다양한 산업용 난방 프로세스에서 전문성을 쌓아 온 Datapaq은 새로운 프로세스 수요에 따라 맞춤형 써멀 보호 기능을 설계할 수 있습니다. 이 데이터시트에서는 전자 어셈블리 산업에 널리 사용되는 써멀 배리어에 대해 설명합니다.

유용한 정보

그림에 보여진 써멀 성능 특성에서는 프로세스가 시작되기 전 데이터 로거와 배리어의 외기 온도가 25°C 이하라고 가정합니다.

프로세스가 종료되는 즉시 써멀 배리어를 열고 로거를 제거해 써멀 배리어에 남아 있는 열로 인해 로거가 뜨거워지는 일이 없도록 해야 합니다.

배리어는 뚜껑이 완전히 열린 상태로 차가운 표면(콘크리트 바닥이나 금속 벤치 위)에 놓아 다음 번에 사용할 때 절연체가 완전히 식은 상태가 되도록 하십시오. 리플로우 프로세스에서 사용한 후 일반적인 냉각 시간은 환경 조건에 따라 대략적으로 5 - 10분 정도입니다.

써멀 성능 표시는 가이드라인으로만 제공되는 것으로, 프로세스마다 다를 수 있습니다. 시스템을 처음 사용할 때는 써멀 성능을 확인해야 합니다.

10/12 채널 데이터 로거 - DQ1810/DQ1812

TB2061/TB2081 - 낮은 높이용 10CH/12CH 써멀 배리어

이 제품은 주로 프로세스 높이가 제한적이고 10개의 써머커플 채널이 필요한 대류 또는 IR 리플로우 솔더링 프로세스에서 사용하도록 설계되었습니다. 높이가 문제가 되지 않는다면 TB2062가 보호 기능과 냉각 시간 측면에서 더 적합합니다.

무게:	0.6kg				
치수(HxWxL):	TB2061 = 28 x 88 x 258mm		TB2081 = 28 x 88 x 274mm		
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	25	13	10	8	7

TB2062/TB2082 - 표준 10CH/12CH 써멀 배리어

TB2062는 주로 대류 또는 IR 리플로우 솔더링 프로세스에 사용하도록 설계된 제품으로, 소형 패키지에서 최적의 절연 속성을 제공하므로 사용 빈도가 많은 경우에 적합합니다. 높이가 제한되어 있다면 TB2061 사용을 고려해 보십시오.

무게:	0.7kg				
치수(HxWxL):	TB2062 = 35 x 88 x 258mm		TB2082 = 35 x 88 x 274mm		
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	36	18	13	11	10

6 채널 협폭 데이터 로거 - DQ1862

TB2020 - 낮은 높이용 협폭 써멀 배리어

이 배리어는 오븐 너비와 높이가 제한된 소형 제품을 제작할 때 적합합니다. 신속한 재사용이 필요하거나 표준 프로세스보다 긴 시간 동안 프로파일링해야 하는 경우에는TB2021 사용을 고려해 보십시오.

무게:	0.5kg				
치수(HxWxL):	28 x 84 x 223 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	25	13	10	8	7

TB2021 - 협폭 써멀 배리어

6ch 협폭 로거에 대한 표준 써멀 배리어

TB2021은 최적의 절연 성능을 제공하며 사용자가 프로세스를 통해 신속하게 시스템을 재사용할 수 있도록 지원합니다. 높이가 제한된 경우 TB2020을 사용하는 것이 좋습니다.

무게:	0.65kg				
치수(HxWxL):	35 x 84 x 223 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	36	18	13	11	10

6 채널 데이터 로거 - DQ1860

TB2064 - 낮은 높이용 써멀 배리어

사용자가 매우 낮은 높이의 오븐에서 리드 프리 프로세스를 프로파일링할 수 있는 매우 높이가 낮은 배리어입니다. 신속한 재사용이 필요하거나 표준 프로세스보다 긴 시간 동안 프로파일링해야 하는 경우에는TB2015 또는 TB2065 사용을 고려해 보십시오.

무게:	0.6kg				
치수(HxWxL):	20 x 133 x 210 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	25	12	9	8	6

TB2015 - 표준 써멀 배리어

전세계 수많은 전자 부품 조립 공장에 사용되는 업계 표준 써멀 배리어입니다. TB2015는 소형 패키지로 최적의 절연 성능을 제공합니다. 높이가 제한된 경우에는 TB2064 사용을 고려하고, 사용 빈도가 매우 많다면 TB2065를 사용하는 것이 좋습니다.

무게:	0.7kg				
치수(HxWxL):	25 x 133 x 210 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	32	16	13	10	9

TB2065 - 긴 지속 시간 써멀 배리어

이 써멀 배리어는 긴 지속 시간과 더 높은 온도 프로세스에 맞게 설계된 제품으로, 종종 반도체 조립 업계에 사용됩니다. 매우 빈번한 리플로우 프로세스 프로파일링이 필요하고 냉각 시간이 제한적인 경우도 이 제품이 적합합니다.

무게:	0.7kg				
치수(HxWxL):	29 x 133 x 210 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	35	18	13	11	10

6 채널 초슬림형 데이터 로거 - DQ1861

TB2066 - 낮은 높이용의 슬림형 써멀 배리어

리드 프리 프로세스를 프로파일링할 수 있는 높이가 매우 낮고 폭이 좁은 써멀 배리어로, 초소형의 높이가 매우 낮은 어셈블리를 조립하는 경우에 적합합니다.

무게:	0.65kg				
치수(HxWxL):	20 x 88 x 334 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	21	11	8	6	6

TB2067 - 표준 슬림형 써멀 배리어

이 제품은 표준 높이에 너비는 가장 좁은 써멀 배리어로, 접근 치수가 제한적인 오븐을 자주 프로파일링하는 경우에 적합합니다. 높이가 제한된 경우에는 TB2066 사용을 고려하고, 사용 빈도가 많다면 TB2068을 사용하는 것이 좋습니다.

무게:	0.75kg				
치수(HxWxL):	25 x 88 x 334 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	28	15	11	10	8

TB2068 - 장기 지속 시간 슬림형 써멀 배리어

이 써멀 배리어는 반도체 조립 업계에 사용되는 고온의 지속 시간이 긴 프로세스용으로 고안된 제품입니다. 매우 빈번한 리플로우 프로세스 프로파일링이 필요하고 냉각 시간이 제한적인 경우도 이 제품이 적합합니다.

무게:	0.8kg				
치수(HxWxL):	29 x 88 x 334 mm				
열 지속 시간:					
온도(°C)	100	150	200	250	280
지속 시간(분)	32	18	13	11	10

유럽 및 아시아
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
전화: +44 (0)1223 423 141
팩스: +44 (0)1223 423 306
이메일: sales@datapaq.co.uk
웹사이트: www.datapaq.com

북미 및 남미
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, USA
전화: +1 978 988 9000
팩스: +1 978 988 0666
이메일: sales@datapaq.com
웹사이트: www.datapaq.com

www.datapaq.com

지속적인 제품 개선으로 인해 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

Brouchure-Q18-K.qxp - Iss 02 - APR08